

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-18

中国天楹股份有限公司

关于申请 2023 年度综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容公告如下：

为支持公司及子公司的发展，解决其生产经营、项目建设以及并购项目等对流动资金及项目贷款的需求，根据公司业务发展规划与财务规划，2023年度公司及子公司拟在现有贷款余额的基础上，再向银行、融资租赁公司等机构申请新增总额不超过153.6亿元人民币的综合授信额度，用于公司及子公司日常生产经营及项目建设所需，授信种类包括但不限于流动资金借款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、委托贷款、置换贷款、信用证、保函、银行票据、保理业务等。

同时提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据各公司的经营和建设情况分配具体的授信额度，并全权代表公司及子公司签署相关授信所必须的各项法律文件。

该事项有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应以在授信额度内实际发生的融资金额为准。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2023年4月29日